

单组分加成型热固有机硅粘接胶

907 技术参考资料

1. 概述

本产品是单组分加成型热固有机硅粘接胶, 通过高温烘烤发生加成反应固化成高性能弹性体。

2. 特性

- ♦ 加热快速固化, 无收缩、不放热
- ♦ 在(-45℃~280℃)温度范围内保持弹性和稳定
- ♦ 无需底涂就可以对较多的基材进行粘合, 例如不锈钢、玻璃、陶瓷等
- ♦ 有极好的高触变性
- ♦ 通过 ROHS\REACH 认证

3. 性能参数 (B88)

固化前性能			
检测项目	参考标准	单位	数值
外观	目测	/	黑色膏状
黏度	GB/T 2794-1995	cps	450000 ± 30000 (6RPM) 360000 ± 30000 (12RPM)
密度	GB/T 13477.2-2002	g/cm ³	1.1±0.05
固化后性能			
检测项目	参考标准	单位	数值
硬度	GB/T 531-1999	Shore A	32±5
体积电阻率	GB/T 1692-92	Ω·cm	$\geq 1.0 \times 10^{14}$
拉伸强度	GB/T 528-2009	MPa	≥ 4.5
伸长率	GB/T 528-2009	%	≥ 350
击穿电压	GB/T 1408.1-1999	KV/mm	≥ 20
剪切强度 (A1:A1)	GB/T 6328-86	MPa	≥ 1.8

以上是 150℃下固化 30min 的物理性能。

4. 主要用途

本品专为各种金属、玻璃、陶瓷基材提供稳定的粘接而设计, 典型的应用有: CIPG 和 FIPG ;

PDU 类产品、动力总成、DC-DC 电源、OBC 及逆变器；
电力电子产品：IGBT 连接器、壳体密封；测量、控制及传感器密封；电子电器产品密封；

5. 包装

310ML/支、180kg/桶

6. 存储

本品为无毒非危险品，避免雨淋和曝晒，25℃以下且未开封条件下保质期为 6 个月。

7. 注意事项

- ◆ 某些材料、化学制剂、固化剂和增塑剂可抑制单组分加成型热固有机硅粘接胶的固化。这些应注意的物质有：
 - A 有机锡和含有机锡的硅橡胶；
 - B 硫、聚硫化合物或含硫物品；
 - C 胺、聚氨酯橡胶或含氨的物品；
 - D 亚磷或含亚磷的物品；
 - E 酸性物品（有机酸）；
 - F 助焊剂残留物；
- 若用胶前怀疑含有上述物质，建议先做样品验证后，再批量生产。

8. 使用说明

- ◆ 为了达到理想的粘结效果，所有表面都必须用合适的溶剂进行清洁和脱脂处理，并确保所有溶剂都被清除。
- ◆ 一般情况下也可以对未经溶剂处理的表面进行粘结，但其结果将取决于基材表面的受污程度和基材的本质。
- ◆ 对于一些较难粘接的材料，例如环氧喷粉件的粘接，可以使用安品的底涂 AP-100-70 进行处理，待基材表面晾干后即可施胶。
- ◆ 固化条件：150 度下通风烘烤 30 分钟。

特别声明：

本说明所提供数据均为特定条件下测得，因使用环境的不同会略有差异；建议使用者在使用前预先测试，以确认是否适合使用目的；在使用过程中有任何问题，请与公司深圳总部联系。